

2026 年 10 月 21 日

日 東 紡

グローバルな電子材料・実装技術のコンソーシアム、HDP（High Density Packaging）に入会

当社は、高速インターコネクトおよびパッケージング技術の進展を推進する世界的なコンソーシアムとして定評のある HDP（High Density Packaging）ユーザーグループに参画しました。HDP は高多層基板における信号品質や高密度実装技術に特化した数多くの革新的な会員主導プロジェクトを主導しており、欧米およびアジアの主要なプリント基板材料メーカーが多数参加しています。



当社の入会は、近年の生成 AI の普及や高速通信の進展に伴い、通信インフラなどで用いられる基板材料の更なる低誘電化や、高速伝送時における信号品質の向上、およびグローバルな評価・測定手法の確立に対するニーズが世界的に高まる中、最先端の技術動向や業界の共通課題をグローバルな主要プレイヤーとともにいち早く把握し、次世代材料の開発・評価を加速させる目的により、実現したものです。

今後は、HDP への参加を通じて、当社の強みである高機能ガラス繊維技術（低誘電特性に優れた NE ガラスや NER ガラス、低熱膨張の T ガラスなど）の知見をコンソーシアム内のプロジェクトで活用し、次世代エレクトロニクス産業における課題解決に貢献していきます。また、グローバルな主要企業との共創やサプライチェーンとの連携をさらに強化することで、先端半導体・AI インフラ市場に向けた製品展開を加速し、当社の電子材料事業の持続的な成長と企業価値の向上を目指していきます。



当社の NER ガラス

以上

■ 本件に関するお問い合わせ先：日東紡 コーポレート・コミュニケーション部 ir@nittobogrp.com